

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2022-030

上海硅产业集团股份有限公司

关于全资子公司投资建设扩产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 项目名称：200mm半导体特色硅片扩产项目
- 实施主体：上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司芬兰Okmetic Oy（以下简称“Okmetic”）
- 投资金额：预计总投资约3.88亿欧元（折合人民币约29.5亿元），均为建设资金，用于厂房及配套设施建设、设备购置及安装等。最终投资总额以实际投资为准，公司将根据项目进展情况按需投入。
- 资金来源：公司自有资金及自筹资金
- 风险提示：本项目的实施，存在一定的审批风险、经营风险、市场风险、财务风险和项目进程及效益不达预期的风险。项目实施过程中可能受国际环境变化、宏观政策变化、市场变化和技术进步等诸多因素的影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加速推进公司长远发展战略规划，抢抓半导体行业发展机遇，持续扩大公司集成电路用200mm半导体硅片的生产规模，提升公司全球硅片市场占有率与竞争优势，公司拟以全资子公司芬兰Okmetic作为项目实施主体，在芬兰万塔市投资建设200mm半导体特色硅片扩产项目。项目建成后，Okmetic将新增每年313.2万片200mm半导体抛光片产能，进一步巩固其在先进传感器、功率器件、射频滤波器及集成无源器件等高端细分领域的市场地位。

本项目预计总投资 3.88 亿欧元（折合人民币约 29.5 亿元），均为建设资金，用于厂房及配套设施建设、设备购置及安装等。最终投资总额以实际投资为准，公司将根据项目进展情况按需投入。

公司拟以自有资金向 Okmetic 增资或提供股东借款不超过 9,000 万欧元（折合人民币约 6.8 亿元），其余建设资金通过自筹方式解决。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2022 年 5 月 10 日召开第一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于投资建设 200mm 半导体特色硅片扩产项目的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会影响募投项目的建设。

（四）本次对外投资不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

（一）实施主体情况

- 1、公司名称：Okmetic Oy
- 2、成立日期：1985 年 5 月 9 日
- 3、注册资本：11,821,250 欧元
- 4、住所：Piitie 2 01510, Vantaa Finland
- 5、主要生产经营地：芬兰万塔市
- 6、主营业务：200mm 及以下半导体硅片（抛光片、SOI）的研发、生产和销售
- 7、股权结构：截至本公告披露日，公司间接持有 Okmetic 100%股权。

（二）投资项目情况

- 1、项目名称：200mm 半导体特色硅片扩产项目
- 2、实施主体：芬兰 Okmetic Oy
- 3、建设地点：芬兰万塔市
- 4、投资规模：预计总投资 3.88 亿欧元（折合人民币约 29.5 亿元），均为建

设资金，用于厂房及配套设施建设、设备购置及安装等。

5、资金来源：公司自有资金及自筹资金

6、实施方式：公司拟以自有资金向 Okmetic 增资或提供股东借款不超过 9,000 万欧元（折合人民币约 6.8 亿元），增资或借款后公司仍间接持有 Okmetic 100% 股权。其余建设资金通过自筹方式解决。

7、建设内容：本项目新增投资约 3.88 亿欧元（折合人民币约 29.5 亿元），建成后形成 313.2 万片的 200mm 半导体抛光片年产能。其中，一期计划投资 2.6 亿欧元（折合人民币约 19.8 亿元），先行完成厂房及配套设施建设，并形成 157.2 万片的 200mm 半导体抛光片年产能；二期将根据行业环境、市场需求等情况确定具体实施时间，计划新增投资 1.28 亿欧元（折合人民币约 9.7 亿元），建成后形成总计 313.2 万片的 200mm 半导体抛光片产能。

（三）项目实施的必要性和可行性

1、加速扩产是抓住当前市场机遇的积极举措

根据 SEMI 预测，至 2024 年全球半导体制造 200mm 晶圆厂的产能将较 2020 年提高 17%，达到每月 660 万个晶圆的历史新高；同期，全球将增加 22 个新的 200mm 晶圆制造厂，以满足对 5G、汽车电子和物联网（IoT）设备不断增长的需求。对此，公司将紧紧围绕市场所需，结合自身资源和 Okmetic 在上述高端细分市场的优势地位，抓住当前市场机遇、加速 200mm 特色硅片扩产。这是公司积极进行全球化布局的重要举措，符合公司战略方向。

2、公司拥有进一步发展 200mm 特色硅片业务的资源优势

Okmetic 长期深耕于半导体硅片材料领域，积累了全球化的客户基础和完善的体系，在相关高端细分市场领域建立了深厚而稳固的客户关系。在经历的多个半导体行业周期中，Okmetic 始终保持了稳定的增长和盈利能力。本项目的建设，可以充分发挥 Okmetic 已有技术、品牌、市场优势，进一步巩固在细分应用市场的竞争优势，提升公司综合竞争力。

3、公司具备积极发展 200mm 特色硅片业务的技术能力

Okmetic 专注于面向高端传感器、射频和功率等应用的定制化特色产品，在近 40 年的发展历程中，积累了成熟的工艺技术和拥有自主知识产权的核心关键技术，面向不断增长的高端细分市场应用的特色工艺能力是 Okmetic 在目标领域

处于全球领先地位的重要基础，也为公司进一步发展 200mm 特色硅片业务提供了技术保障。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资是公司长期发展战略规划落地的重要组成部分，将加快公司产能提升，抢抓半导体行业发展机遇，持续优化产品结构，进一步提升公司综合竞争力。项目达产后，公司面向高端传感器、射频、功率应用的 200mm 半导体抛光片产品的产能将扩大，有利于提升公司在 5G、汽车电子、物联网（IoT）等细分领域的市场份额、巩固竞争优势。公司及 Okmetic 在现有市场体系和品牌影响力，也将有利于本次投资项目所涉及产品的市场推广和销售，持续提升公司业务规模和持续盈利能力。

本次投资不涉及关联交易，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、审批风险

本次投资尚需取得投资项目在芬兰万塔的施工许可、环境许可等审批手续，项目能否按计划实施，存在一定不确定性。此外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

2、经营风险

本项目未来若因建筑施工方原因、政府基础设施配套、设备采购或其他政策落实不到位以及其他不可抗力因素等影响导致设备交付、正式投产时间延长等，则可能导致投入超支、产能释放滞后、经济效益不达预期等情况，并将对公司生产经营产生不利影响。

3、市场风险

本项目主要生产 200mm 硅片，所处的半导体硅片行业处于半导体产业链的上游，其需求直接受到下游芯片制造及终端应用市场的影响。如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致终端市场需求下降，或者半导体行业发生趋势性下行，导致市场需求与预期出现偏差，存在新增产能无法及时消化的风险。

4、财务风险

本项目投产后，若市场情况发生不可预见的变化，导致项目未能如期实现效益，新增折旧及摊销将导致公司净资产收益率出现下降，对公司经营效益产生不利影响。本次对外投资在短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。

5、项目进程及效益不达预期的风险

本项目投资建设周期较长，在后续实施过程中可能存在经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划可能性。

本项目建设过程中，可能受国际环境变化、宏观政策变化、市场变化和技术进步等诸多因素的影响，项目可能存在市场发生变化、项目实施进度不达预期、市场销售不理想等方面的风险，这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022年5月11日